Revista Electrónica de Ingeniería y Aplicación

REIA 2024

http://reia.iteshu.edu.mx/

Revista arbitrada por pares
ISSN 2448-6817

Inicio de recepción de artículos
11 de marzo 2024

Fecha límite para recepción de artículos
31 de mayo 2024

Notificación de trabajos aceptados para
30 de junio 2024

Costo $1,841.00

ENERGÍAS RENOVABLES

- ENERGÍA SOLAR
- ENERGÍA EÓLICA
- BIOCOMBUSTIBLES
- ENERGÍA GEOTÉRMICA
- COGENERACIÓN

SISTEMAS COMPUTACIONALES

- INNOVACIÓN EN TIC´S
- INGENIERÍA DE SOFTWARE
- BASE DE DATOS

INNOVACIÓN AGRÍCOLA SUSTENTABLE

- AGROECOLOGÍA
- AGRONEGOCIOS
- CULTIVOS HIDROPÓNICOS
- AGRICULTURA PROTEGIDA
- MICROPROPAGACIÓN
- GENÓMICA

MECATRÓNICA

- ROBÓTICA
- CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN
- PROCESAMIENTO DE SEÑALES Y SISTEMAS INTELIGENTES
- MODELADO MATEMÁTICO Y SIMULACIÓN
- SISTEMAS EMBEBIDOS
- SISTEMAS MECATRÓNICOS

Correo de contacto: reia@iteshu.edu.mx
tel: 761 7248080 ext. 1028

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO ITESHU SUPERIOR DE HUICHAPAN
EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA